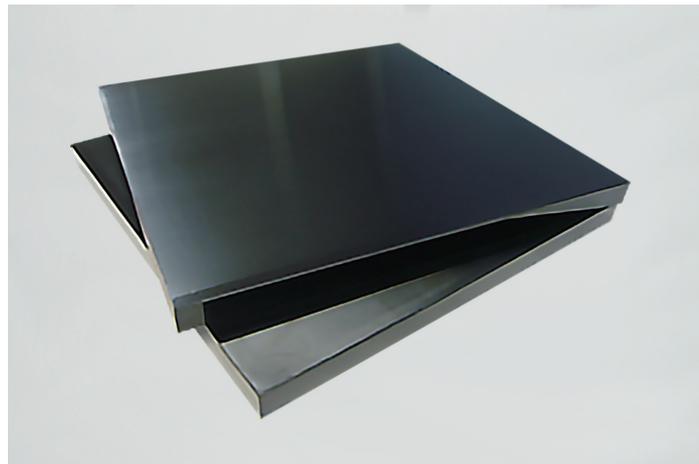


PBIは、NASA（米航空宇宙局）、AFML（米空軍材料研究所）で共同開発された耐熱・高性能樹脂です。600度を超える熱分解温度を持ち、樹脂としては最高域の耐熱性と力学的性質を有しております。



規格サイズ

板	長さ × 幅 × 厚み (mm) 305 x 305 x (50)
棒	直径 × 長さ (mm) 規格なし

※上記以外のサイズもございます。
個別にお問合せください。

特徴

耐熱性	荷重たわみ温度 (1.8MPa) 410°C ガラス転移温度 (Tg) 420°C と樹脂最高域の耐熱性です。
機械的特性	アルミ同等レベルの引張強度。 とりわけ高温下で優れた機械特性を有します。
耐プラズマ性	真空中でのアウトガスが少なく、高いプラズマ耐性を有します。 (半導体チャンバーでは SCM7000HP をご利用ください)
耐摩耗性	高温下 (300°C) においても良好な耐摩耗性を発揮します。
耐溶剤性	有機溶剤に優れた耐性を有します。

各種グレード

高純度グレード (SCM7000HP)

圧縮成型品
低不純物・低アウトガスグレード
半導体製造工程（真空チャンバー内他）対応となります。

PEEK アロイ 炭素繊維強化グレード (SPR7960) ※旧 TF-60C

射出成型品
PBI-PEEK アロイ 炭素繊維強化
板・・・305 x 200 x 11、100 x 100 x 6.35

カーボン繊維強化グレード (SCM7600)

圧縮成型品
炭素繊維添加グレード
耐摩耗性の向上
板・・・305 x 305 x 40

PEEK アロイ 摺動グレード (SPR79L0) ※旧 TL-60

射出成型品
PBI-PEEK アロイ 炭疽繊維、ボロン、グラファイト充填
板・・・100 x 100 x 6.35

用途例

半導体製造装置部品
航空宇宙関連部品

液晶製造装置部品
高温電気絶縁部品 etc

ガラス容器製造装置部品